

MES2024 プログラム (特別セッション)

2024年9月11日 (水) 開始時間 13:00

A会場 (X0202講義室)		B会場 (X0203講義室)		C会場 (X0204講義室)		D会場 (X0205講義室)		
特別企画セッション 「エレクトロニクス実装における機械学習の応用例と展開」		未来をつくれ！若手技術者の大活躍推進セッション		ロードマップセッション 『2024年度版実装技術ロードマップ』 -Society 5.0「国民の安全と安心」「Well-being」実現に向けた実装技術の将来動向-		第49回電子デバイス実装研究委員会 共催 (スマートプロセスエレクトロニクス生産部会主催) ～エレクトロニクスにおける検査と分析～		
13:00	11A1-1 (0107) 「深層学習を利用したはんだクラック進展三次元解析 ～はんだ不良解析におけるAI活用の取り組み～」 長谷川将司(㈱オオルテック)	13:00	11B1-1 (0103) 「未来を先送りしない」 益一哉 (東京工業大学 学長)	13:00	11C1-1 (0110) JEITA 2024年度版実装技術ロードマップ① 「注目される市場と電子機器群」 尾崎裕司 (ナミックス㈱) 杉崎吉昭 (㈱東芝)	13:00	11D1-1 (0114) 「X線位相イメージング・位相CTによる高感度非破壊検査」 百生敦 (東北大学 多元物質科学研究所)	
14:00	11A1-2 (0106) 「伝熱工学×機械学習による温度予測式を自動生成する技術の開発」 鈴木智之(㈱東芝研究開発センター)	13:40	11B1-2 (0097) 「若手と女性技術者がエレクトロニクス業界で輝くために」 須永順子 ((一社) 情報社会デザイン協会 理事)	14:00	11C1-2 (0111) JEITA 2024年度版実装技術ロードマップ② 「電子デバイスパッケージ」 尾崎裕司 (ナミックス㈱)	13:40	11D1-2 (0115) 「オートメーション化を支える高速・高精細な3D X線自動検査技術」 笠原啓雅 (オムロン㈱)	
15:00	休憩 (10分)						14:20	休憩 (10分)
15:10	11A2-1 「音声情報処理における機械学習」 上乃聖(名古屋工業大学)	15:10	11B2-1 若手講演① 青山颯 (群馬大学大学院) 若手講演② 瀬口暹佳(公立諏訪東京理科大学) 若手講演③ YILYIYA AISHAN(大阪公立大学) 若手講演④ 王俊沙 (明星大学)	15:10	11C2-1 (0112) 部品内蔵 ロードマップセッション 「部品内蔵技術ロードマップ2022年度版概要」 搭載技術 松澤浩彦 (㈱図研) 部品内蔵技術委員会ロードマップ研究会 幹事	15:10	11D2-2 (0117) 「パルスNMRによる粉体の濡れ性および濃厚分散体の評価」 池田純子 (マジェリカ・ジャパン㈱・東北大学 多元物質科学研究所)	
16:10	11A2-2 (0109) 「大規模言語モデルの基本と実社会応用に向けた研究事例」 白松俊(名古屋工業大学)	16:00	休憩 (10分)	16:10	11C2-2 (0113) 部品内蔵 ロードマップセッション 「部品内蔵技術ロードマップ2022年度版概要」 検査・試験 松澤浩彦 (㈱図研) 部品内蔵技術委員会ロードマップ研究会 幹事	15:50	11D2-3 (0118) 「ソルダリング接合部の自動視覚検査」 松嶋道也 (大阪大学)	
17:10	終了						16:30	

MES2024 プログラム (一般講演・企業セッション・ポスターセッション・表彰式・特別講演)

2024年9月12日 (木) 開始時間 9:00

A会場 (X0202講義室)		B会場 (X0203講義室)		C会場 (X0204講義室)		D会場 (X0205講義室)		
	先端プロセス・実装技術	信頼性技術1		高速高周波実装・電磁特性技術		企業プレゼンテーション 10:00開始 (1社:10分以内 質疑なし)		
9:00	12A1-1 (0001) 「10 μm段差を有する絶縁膜の平坦化技術」 秋山勝哉(ソニーセミコンダクタソリューションズ)	12B1-1 (0013) 「半導体デバイス開発に向けた拡張TLM法による接触抵抗の測定」 桂草皓(京都工芸繊維大学)		12C1-1 (0051) 「銀シードセミアティティブ法による銅配線形成」 田村礼(DIC)				
9:20	12A1-2 (0016) 「ロータス型ボラス銅/はんだ複合接合部の熱伝導率評価」 平瀬加奈(大阪大学大学院)	12B1-2 (0023) 「ボトムターミネーション部品の高信頼性実装プロセスの検討」 岡本佳之(コーセル)		12C1-2 (0078) 「メタサーフェスを利用した広帯域・薄型円偏波アンテナ」 越地福朗(東京工芸大学)				
9:40	12A1-3 (0002) 「3D積層デバイス向けTSVのCu pumping評価」 山野友梨子(ソニーセミコンダクタソリューションズ)	12B1-3 (0033) 「パネグリップドアレイセラミックパッケージ実装サンプルの熱衝撃サイクル耐性」 篠崎孝一(宇宙航空研究開発機構)		12C1-3 (0039) 「埋込み型運動量計に対する3軸磁界ワイヤレス給電システムの検討」 大原史久(東京理科大学)		10:00 12D1-1 (0011) シーメンス(株) 「構造関数とROMを活用した高精度熱解析モデルの企業間共有」 武井春樹		
10:00	休憩 (10分)						12D1-2 (0020) (株)サーモグラフィクス 「高熱伝導グラファイトを用いた高性能ヒートスプレッダー」 小西大介	
	先端プロセス・実装技術	信頼性技術1		マイクロメカトロニクス実装技術		12D1-3 (0022) メルテックス(株) 「アルミニウム電極上に厚膜形成可能な中性無電解銅めっき液」 長島未希		
10:10	12A2-1 (0048) 「ギ酸塩被膜処理したSn-Znはんだ付における接合温度の影響」 山崎浩次(群馬大学)	12B2-1 (0045) 「温度サイクル信頼性試験前にパッケージ基板をベーク処理の必要性」 謝明君(大阪大学)		12C2-1 (0083) 「SEM内昇温引張試験システムによるナノ銀焼結膜の破壊現象理解」 生津資大(京都先端科学大学)		12D1-4 (0012) (株)スフィンクス・テクノロジー 「材料を含む製造工程の低炭素化に貢献する局所IHはんだ付け装置」 高柳毅		
10:30	12A2-2 (0076) 「ハイブリット接合における洗浄プロセスとCuパッドリセスの関係」 小池美夏(ソニーセミコンダクタソリューションズ)	12B2-2 (0047) 「リフロー実装に対応するはんだ付け性試験の新規前処理の検討」 泉水崇彰(TDK)		12C2-2 (0066) 「電子素子の昇温を抑制するMEMSペーパーチャンパーの開発」 金子美泉(日本大学)		12D1-5 (0056) 住友金属鉱山(株) 「透明フレキシブル基板用銅積層基板(透明FCCL)のご紹介」 浅川吉幸		
10:50	12A2-3 (0087) 「ピエゾトランスデューサー用Si/Cu同時研削装置の開発」 渡辺直也(国研 産業技術総合研究所)	12B2-3 (0070) 「Cu/Sn-0.7Cu接合部のエレクトロマイグレーション現象」 山中公博(中京大学)		12C2-3 (0004) 「マイクロLEDディスプレイ向け高速実装技術の開発」 武久翔多(東レエンジニアリング)		12D1-6 (0017) (株)JCU 「Ti/Cu/Suパッチシード層一括ETCHングプロセス」 三田根斗		
11:10	休憩 (10分)						12D1-7 (0069) ティー・エイ・インストルメント・ジャパン(株) 「導電性インクの分散状態・焼結プロセスの評価」 川田友紀	
11:20	12P1 ポスターショートプレゼンテーション 14件 A会場 (BC会場サテライト) 40分 (2分以内発表・質疑なし)							
	12P1-1 (0018) 中筋渉 (関西大学大学院)		12P1-2 (0046) WuKejun (ウシオ電機(株))		12P1-3 (0079) 後藤慎太郎 (東北大学)			
	12P1-4 (0005) 藤野品仁 (田中貴金属工業(株))		12P1-5 (0034) 武石悠二郎 (大阪大学)		12P1-6 (0049) 石川善恵 (国研 産業技術総合研究所)			
	12P1-7 (0032) 岸本貴臣 (田中貴金属工業(株))		12P1-8 (0015) 松永昌大 (株)レゾナック		12P1-9 (0009) 藤井郁晃 (公立諏訪東京理科大学)			
	12P1-10(0080) 大塚凌平 (法政大学)		12P1-11(0081) 山口紗羅 (法政大学)		12P1-12 (0029) 平見朋之 (ウシオ電機(株))			
	12P1-13(0061) 菊地輝優 (東京工芸大学大学院)		12P1-14(0021) 泉小波 (産業技術総合研究所)					
12:00	昼食 (60分)							
13:00	12P2 ポスターセッション・企業展示コアセッション 1 (80分)							
	ポスター展示: 14所属 企業展示: 18社 A:ソニーセミコンダクタソリューションズ(株)、B:奥野製薬工業(株)、C:シーメンス(株)、D:(株)スフィンクス・テクノロジー、E:(株)国研、F:(株)JCU、G:(株)サーモグラフィクス、H:メルテックス(株)、I:(株)野田スクリーン、J:住友金属鉱山(株)、K:ティー・エイ・インストルメント・ジャパン(株)、L:サンコレック(株)、M:オムロン(株)、N:タカヤ(株)、O:Patentix(株)、P:マジエリカ・ジャパン(株)、Q:レーザーテック(株)、R:(株)先端力学シミュレーション研究所							
14:20	休憩 (10分)							
14:30	12F1 表彰式 (A会場にて開催、BCD会場サテライト) 司会: 実行委員長 組織委員長挨拶、JIEP副会長挨拶 第33回マイクロエレクトロニクスシンポジウム (MES2023) ベストペーパー賞 5件、研究奨励賞5件 表彰報告 MES論文委員長 第38回春季講演大会 優秀賞: 5件、研究奨励賞: 5件、ポスターアワード: 1件 表彰 第38回春季講演大会プログラム委員長							
15:00	休憩 (10分)							
15:10	12F2-1 特別講演1 (A会場にて開催、BCD会場サテライト) 座長: 山田靖 (大同大学) 組織委員長 「企業経営と大学経営 双方に携わって思うこと」 武藤大 (学校法人大同学園 理事長)							
16:10	休憩 (10分)							
16:20	12F2-2 特別講演2 (A会場にて開催、BCD会場サテライト) 座長: 山田靖 (大同大学) 組織委員長 「三菱電機のパワーモジュールの技術動向」 別芝範之 (三菱電機株式会社 コンポーネント製造 技術センターパワーデバイス・モジュール技術推進部 部長)							
17:20	移動							
18:00	12E1 交流会 (金山駅) ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋2階 「ガーデンコート」 司会: 実行副委員長							
19:50	終了							

MES2024 プログラム (一般講演・依頼講演)

2024年9月13日(金) 開始時間 9:40

A会場 (X0202講義室)		B会場 (X0203講義室)		C会場 (X0204講義室)		D会場 (X0205講義室)	
パワーエレクトロニクス実装技術		信頼性技術2		プリンタブル・ウェアラブル・バイオエレクトロニクス		シミュレーション・計算機による評価・設計	
9:40	13A1-1 (0007) 「片面冷却パワーモジュールの低熱抵抗構造の検討」 久持裕史 (㈱IHI)	13B1-1 (0027) 「冷熱サイクル試験前後のはんだ接合の非破壊大面積方位マッピング」 林雄二郎 (理化学研究所)	13C1-1 (0024) 「調製方法の異なるシルクフィロインフィルムの構造と物性」 木村海帆 (産業技術総合研究所)				
10:00	13A1-2 (0003) 「SiCパワーデバイスのための過渡熱抵抗測定システムの開発」 福永崇平 (大阪大学)	13B1-2 (0038) 「ラマン分光によるn形GaNのオーミック電極界面の高温電子物性」 松田拓大 (中京大学)	13C1-2 (0026) 「インプラント構造を用いた硬さセンサの開発とウェアラブル応用」 奈良健汰 (山形大学)	10:00	13D1-1 (0096) 【依頼講演】 「周期構造を有する伝送線路によるクロストーク抑制技術のインターポーザへの適用検討」 大島大輔 (日本アイ・ピー・エム㈱)		
10:20	13A1-3 (0062) 「EISでの鉛フリーはんだの電ロマイグレーション寿命予測」 大越壮樹 (宇都宮大学大学院)	13B1-3 (0040) 「Ni-P/Auめっき及びSn-Bi系合金バンプの継手特性評価」 川上夏輝 (大阪大学)	13C1-3 (0043) 「ペンタセンOTFTの合掌曲げ疲労における負荷方向依存性」 福田将平 (鹿児島大学)				
10:40	休憩 (10分)						
10:50	13A2-1 (0055) 「高温環境下焼結接合部の異方的組織進展評価」 松田朋己 (大阪大学)	13B2-1 (0058) 「半導体パッケージ構造におけるSiダイ / アンダーフィル界面の疲労き裂進展速度」 大木勇汰 (芝浦工業大学大学院)	13C2-1 (0044) 「COP基板に形成されたAg伝送線路の機械的負荷後の高周波特性」 難波広樹 (鹿児島大学)	10:50	13D2-1 (0042) 「パワーデバイスの3次元有限要素法解析の近似器構築」 岩田剛治 (大阪大学)		
11:10	13A2-2 (0057) 「ZnAl共析合金を用いた電子実装部の高温接合プロセスの開発」 倉員友希 (鹿児島大学大学院)	13B2-2 (0060) 「Siダイ / アンダーフィル界面の疲労き裂進展速度におよぼす球状シリカフィラー添加量および粒度分布の影響」 田中宏樹 (芝浦工業大学大学院)	13C2-2 (0082) 「ストレッチャブル印刷配線の電気抵抗変動に及ぼす構成材料の粘弾性特性の影響粘弾性挙動の影響」 山本凜太郎 (群馬大学)	11:10	13D2-2 (0054) 「分子動力学法によるCu-Cu接合界面のポイド消失挙動の評価」 巽裕章 (大阪大学)		
11:30	13A2-3 (0063) 「ZnAl共析合金の冷却前容体化時間と冷却後の結晶粒径の関係」 寺地智紀 (鹿児島大学大学院)	13B2-3 (0059) 「フィールド環境におけるBGA (Ball Grid Array) 半導体パッケージはんだ接合部の熱疲労駆動力におよぼす材料因子解析」 加藤遼 (芝浦工業大学大学院)	13C2-3 (0088) 「カーボンナチューブ間界面抵抗低下の速度論に及ぼすバインダ配合の影響」 井上雅博 (群馬大学)	11:30	13D2-3 (0067) 「放熱材中のフィラーと樹脂間のフォノン伝導による3D熱伝達解析」 荒尾修 (㈱デンソー)		
11:50	13P-1 昼食・企業展示コアセッション2 (70分) 企業展示: 18社 A: ソニーセミコンダクタソリューションズ㈱、B: 奥野製薬工業㈱、C: シーメンス㈱、D: ㈱スフィンクス・テクノロジーズ、E: ㈱図研、F: ㈱JCU、G: ㈱サーモグラフィクス、H: メルテックス㈱、I: ㈱野田スクリーン、J: 住友金属鉱山㈱、K: ティー・エイ・インストルメント・ジャパン㈱、L: サンユレック㈱、M: オムロン㈱、N: タカヤ㈱、O: Patentix㈱、P: マジエリカ・ジャパン㈱、Q: レーザーテック㈱、R: ㈱先端力学シミュレーション研究所						
最先端材料		信頼性技術3		環境調和型エレクトロニクス		光回路実装技術	
13:00	13A3-1 (0094) 【依頼講演】 「コンデンサ内蔵基板を使った次世代High Performance Computing(HPC)向けDC-DCコンバータモジュール」 糸山寿毅 (㈱村田製作所)	13B3-1 (0095) 【依頼講演】 「車載電子部品の品質確保の取り組み」 西森久雄 (トヨタ自動車㈱)	13C3-1 (0098) 【依頼講演】 「ナノカーボン材料に基づくフレキシブルエレクトロニクス」 大野雄高 (名古屋大学)	13:00	13D3-1 (0104) 【依頼講演】 「CPO適用に向けたポリマー光導波路型結合素子」 木下遼太 (住友ベークライト㈱)		
13:40	13A3-2 (0006) 「新規Cu系活性ろう材を用いたセラミックス回路基板の信頼性評価」 遠藤瑞生 (㈱プロテリアル)	13B3-2 (0019) 「薄膜引張試験によるエポキシ封止材機械特性の温度依存性評価」 浮田昌也 (ローム㈱)	13C3-2 (0091) 「マイクロビアの無電解銅めっき層の元素分析評価」 西嶋雅彦 (大阪大学)	13:40	13D3-2 (0030) 「CPO用光導波路付きパッケージ基板の開発」 北乾巧也 (京セラ㈱)		
14:00	13A3-3 (0041) 「低温Cu-Sn遷移液相拡散接合のためのSn-Bi合金活用法の検討」 黒沢憲吾 (秋田県産業技術センター)	13B3-3 (0035) 「ラマン分光によるSiC-SBDのSiC/SiO ₂ の熱応力解析」 清住竜也 (中京大学)	13C3-3 (0092) 「Sn-Bi系低融点はんだ合金の諸特性研究と実装について」 西村哲郎 (㈱日本スベリア社)	14:00	13D3-3 (0050) 「超小型106Gb/s × 8チャンネルVCSELトランシーバ」 吉田航 (古河電気工業㈱)		
14:20	休憩 (10分)						
最先端材料		信頼性技術3		環境調和型エレクトロニクス		めっき技術	
14:30	13A4-1 (0084) 「真空紫外光による低誘電性封止材の表面改質と密着性」 辻祐友 (大阪公立大学)	13B4-1 (0036) 「ラマン分光による応力負荷されたSiCの電極界面の熱応力の評価」 石田秀 (中京大学)	13C4-1 (0025) 「Sn電解精錬におけるアノードスライム発生と不動態化との関係」 土屋政人 (宇都宮大学大学院)	14:30	13D4-1 (0028) 「銀焼結接合に適した無電解めっき皮膜」 瀬戸寛生 (奥野製薬工業㈱)		
14:50	13A4-2 (0086) 「金属架橋型導電性接着剤の架橋が銅との接合強度にもたらす影響」 平林湧 (大阪大学大学院)	13B4-2 (0037) 「ラマン分光法によるn形GaNのオーミック電極界面の熱応力解析」 松下広大 (中京大学)	13C4-2 (0065) 「水溶液中に分散したグラフェンへの電気化学ドーピングの検討」 田中雄登 (大阪公立大学)	14:50	13D4-2 (0064) 「高密度銅めっき回路形成技術とフィルムやガラス基板への応用」 川上雄介 (㈱ニコン)		
15:10	13A4-3 (0089) 「銅系導電性ペーストのフィラー酸化状態と電気伝導特性の関係」 井上雅博 (群馬大学)	13B4-3 (0053) 「表面計測とCAEによるパワーモジュールの信頼性評価手法の検討」 石田和也 (㈱先端力学シミュレーション研究所)	13C4-3 (0072) 「熱硬化性樹脂の平均粒子径と賦活温度による活性炭構造への影響」 田中良弥 (大阪公立大学)	15:10	13D4-3 (0085) 「新規銅パターンめっき法を用いたメタサーフェスフィルムの作製」 中澤悠人 (㈱イオックス)		
15:30	13A4-4 (0090) 「樹脂結合型導電性接着剤における種々の銀マイクロフィラー焼結挙動」 福島孝典 (群馬大学)	13B4-4 (0068) 「パワーサイクル試験におけるSiC-MOSFET温度特性の影響」 加藤史樹 (国研 産業技術総合研究所)	13C4-4 (0075) 「セルロース由来活性炭の収率向上と電気二重層キャパシタ特性」 YILYAAISHAN (大阪公立大学)	15:30			
15:50	終了						